

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表

编号：2022-02-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	招商证券：鄢凡、程鑫 兴证全球基金：邹欣、程剑、涂围、童兰、董理、孙统
时间	15：00~16:30
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、肖晓月
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司简介</p> <p>公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起家，2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR 和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。公司坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB 到半导体测试板、IC 封装基板的产品、技术和客户升级。自 2018 年起公司开始步入产能扩张阶段，前期投资产能正逐步释放，产能规模、收入规模逐步提升，公司成长空间进一步打开。</p> <p>未来公司的重点工作是推动广州兴科项目 IC 封装基板业务的投资扩产及广州 FCBGA 项目的投资建设。</p>

二、公司相关产能及规划介绍

PCB 业务：2020 年度，广州生产基地产能为 33.72 万平方米/年；宜兴生产基地产能为 25.5 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4 万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为 1.5 万平方米/月，目前产能处于逐步释放过程中；小批量产线在广州生产基地和宜兴生产基地，此次公司启动的非公开发行项目主要是宜兴生产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分期建设投产。

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。主要经营主体有美国 HARBOR、广州科技。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 HRABOR 提供产能支持。

IC 封装基板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已处于满产状态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，目前已在珠海完成厂房建设，处于产线安装调试阶段。FCBGA 目前处于筹建阶段，预计 2024 年开始量产爬坡。

三、IC 封装基板行业竞争预判

2020 年全球 IC 封装基板行业规模 100 亿美金，增长 25%；Prismark 预测 2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160~170 亿元，复合增长率预期为 9.7%，届时 IC 封装基板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。2020 年内资载板厂规模为 4 亿元美金，全球市场占有率仅为 4%，而国内封测厂全球市场占有率为 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产必将带动 IC 封装基板行业需求的增长，行业赛道好，玩家少。

公司从 2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现预设经营目标。公司在封装基板领域积累了丰富的经验，且已通过三星认证，从侧面说明了公司的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可。

IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家。行业新进入者需要组建经验丰富的团队，在当前行业高景气度下团队组建成本较高，且从组建团队、拿地建厂、装修调试到产能爬坡，完成大客户认证，保守估计至少需要 2~3 年时间，因此预计未来 2~3 年新进入者仍无法成长到足以与公司比肩，产业链供需格局预期仍乐观。

四、IC 封装基板下游应用及客户情况介绍

存储类载板因需求量最大，是公司目前主要目标市场。公司目前 IC 封装基板下游应用营收占比为：存储类占比约 2/3，指纹识别、射频、物联网相关占比约 20%，预计未来将维持前述产品类型结构。客户占比情况为：大陆客户占比约 2/3，台湾客户占比约 20%，韩国客户占比约 10%，下游大陆厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。

五、IC 封装基板客户来源介绍

公司经过二十多年的市场耕耘，积累了深厚的客户资源，公司客户多为下游多个行业领先企业或龙头企业，且所涉行业较广，不依赖单一行业、单一客户。而 IC 封装基板业务客户来源一定程度上由团队及产品类型决定。

六、公司对 ABF 载板的规划

ABF 载板是公司未来的战略方向，公司拟在广州投资约 60 亿元建设 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目，分两期建设月产能为 2,000 万颗的 FCBGA 封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。目前已初步完成团队组建，团队具备建厂及量产能力，但该项投资建设周期、产能、达产时间尚具不确定性，如能实现突破将为公司带来新的利润增长点，公司将控制投资节奏，降低投资风险。

附件清单	无
日期	2 月 15 日